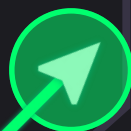


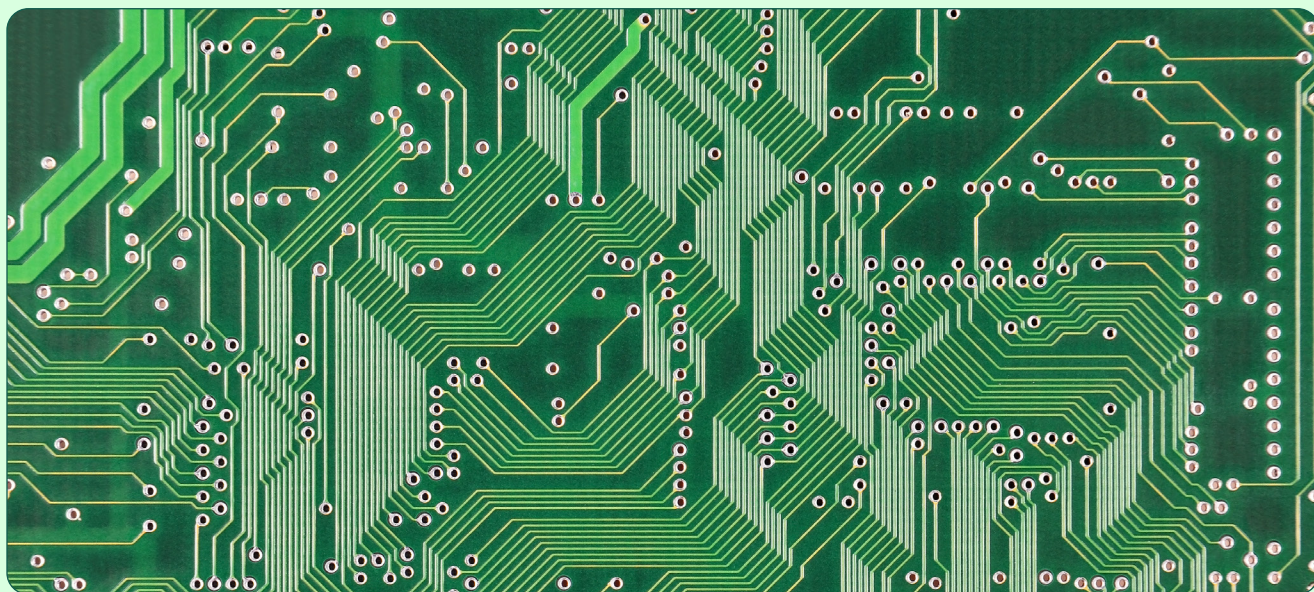
State of the Industry Report

洞见 | 趋势 | 预测

从过剩到平衡

电子元件供应链的未来之路





目录

1

概要

02

2

2024：过剩状态与库存挑战之年

03

3

2025：变局中的审慎乐观

05

4

行业展望

07

5

全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈

11

6

2025制胜战略框架

14

从过剩到平衡

电子元件供应链的未来之路

2025年或将成为电子元件供应链走出长期过剩周期并迈向可持续需求阶段的关键转折年份——至少整个行业普遍保持这一期待。尽管这一前景振奋人心，但其实现仍可能面临重重阻碍。

2024年初，制造商希望AI（人工智能）技术的发展能够驱动增长，积极的势头带动着整

个行业同样信心满满。然而，AI（人工智能）虽然确实为市场注入了复苏动力，但仍不足以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整体需求愈发疲软，库存过剩的问题也普遍蔓延。制造商试图向高利润产品转移，但持续的供需失衡仍使其盈利修复过程面临不小的压力。

“2024年的核心命题仍然是‘不确定性’，这一态势将延续至2025年。当前库存水平已逐步趋于正常，客户再次下单的行为也表明其过剩库存已经逐步出清。”

Marcus Chen

Fusion Worldwide（孚昇电子）执行副总裁

复苏进程显著慢于预期：高成本抑制了需求水平，地缘政治持续的不确定性更是加剧了买方的观望情绪。然而，利率下行或为2025年的投资与消费注入活力。2024年第四季度的交付周期延长，暗示了采购动能的回升，客户正重返市场进行库存回补。

2025年，成本管控仍是重中之重，但积极的采购布局与战略合作也将成为构建供应链韧性的同等要务。依托可靠市场情报的灵活采购

策略，将成为平衡2024年遗留难题与2025年新兴机遇的关键所在。

2025年究竟是真正复苏的起点，还是不确定性主导的又一周期？本报告将深度解读2024年关键趋势及其对来年的影响。

2024：过剩状态与库存挑战之年

2024年初，制造商对AI（人工智能）需求增长的期待带动业内的乐观情绪再度升温。[Deloitte（德勤）对标普全球数据](#)的分析显示，制造业采购经理人指数（PMI）在2024年初进入扩张区间——这是自2023年4月以来的首次回升。

点击此处阅读[State of the Industry Report 2024年第一辑](#)了解2024年初的前景展望。

点击此处下载 

“经历两年半的严重短缺冲击后，今年供应链终于回归‘常态’。随着企业逐步适应新环境，采购趋势也发生了显著转变。”

Jason Brake

采购总监（欧洲、中东和非洲地区）

过去一年内，供需格局向更平衡的状态逐步过渡，机遇与挑战也争相涌现。

欲了解AI（人工智能）如何影响2024年的内存市场，点击此处阅读[State of the Industry Report 2024年第二辑](#)

点击此处下载 

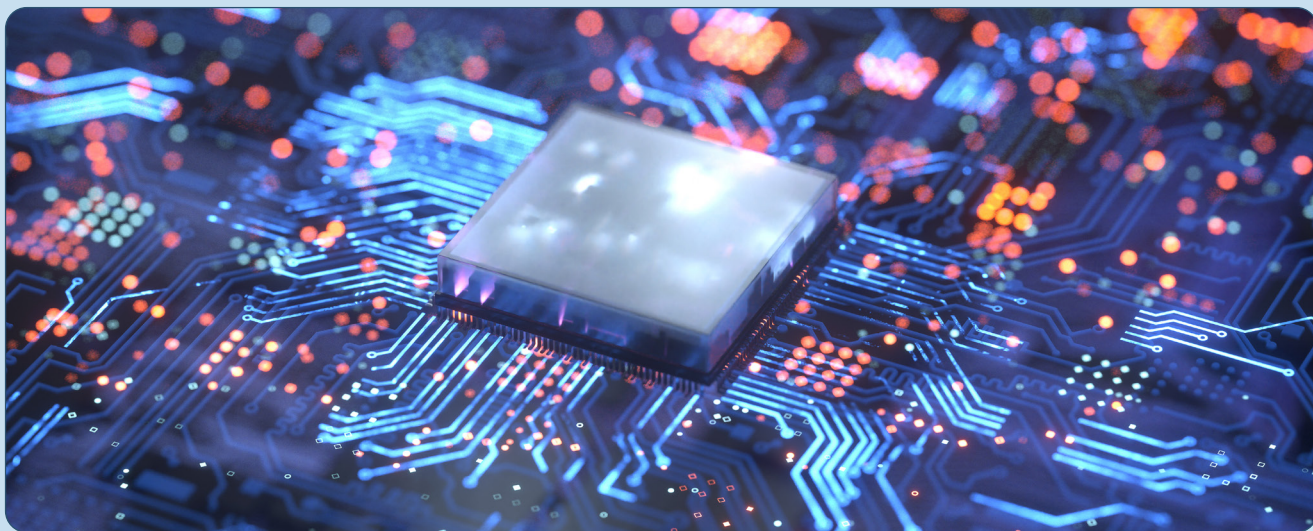
AI（人工智能）作为需求的驱动力迅速崛起，制造商曾希望这一新兴技术发展能够抵销全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI（人工智能）确实提供了不小的助力，却仍未能完全克服阻碍市场全面复苏的其他挑战。

库存过剩仍是当前最强劲的逆风，在供应短缺趋势持续的状态下更为凸显。企业仍在消化短缺时期超额订购的后果，叠加价格压

力和需求模式演变，整体困境进一步加剧。在制造商努力应对这些挑战之时，部分元件的表现揭示了市场动荡的全貌：集成电路（IC）和被动元件等品类难以重振势头，但内存产品却显现出逐步复苏的迹象。

截至3月，“库存消化周期当前处于何种阶段？”这一追问已成为行业焦点，各方都迫切希望卸下过剩库存的重负。

2024年年中，全球电子市场陷入复杂局面：复苏预期与持续挑战形成拉锯。然而截至年末时点，乐观信号逐步显现——制造商普遍认为市场已经触底，客户也将再次寻求供应。尽管行业间分化显著，但价格趋稳以及制造商对供需动态管控信心的提升，都为市场注入了积极的预期。



年度前瞻

尽管2025年的市场预期波动水平将弱于2024年，但关键市场的调整仍有余地。主动元件潜在供应紧张已有传闻，EMS（电子制造服务）供应商也因此建议客户持货观望，而非折价抛售。即便如此，各企业仍保持审慎姿态。

IC（集成电路）与被动元件板块继续面临逆风，内存板块的韧性则凸显了对塑造需求动态的精细化洞察的重要性。制造商正采取战术性

定价策略，并密切追踪需求信号以动态调节产能。

然而，上述趋势不能孤立研判；全球供应链动态及地缘政治变量的影响无疑将成为重塑行业前景的关键力量。

2025：变局中的 审慎乐观

市场正从过度修正状态逐步回归常态需求水平，这一进程虽然缓慢却仍然释放出积极的信号。制造商注意到，2024年末订单量回升，表明客户在通过促销或生产消耗逐步出清2024年度的过剩库存后，正以审慎态度启动2025年采购计划。

成本管控与技术创新的平衡

各企业的重心依旧在费用和现金流的管控上，[成本节约](#)仍是企业核心战略。尽管如此，由于技术迭代需求空前迫切，企业投资就必须足够精准。制造商需要推出尖端产品以

满足消费者需求，[AMD（美国超威半导体公司）](#)、[Intel（英特尔）](#)、[Micron（美光）](#)、[Samsung（三星）](#)和[Nvidia（英伟达）](#)等头部厂商间的竞争日趋白热化。

“制造商持续优化供应链以提升其盈利能力，这往往涉及产能分配的艰难抉择。此类决策可能引发价格、交付周期及供货水平的区域分化。”

Evan Maniquis

销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区）

上市企业在当前高压环境中面临争夺市场份额的严峻考验。为避免亏损，IC（集成电路）制造商正效仿内存供应商2024年的策略，

要求客户提交需求预测以锁定产能配额。若缺乏需求预测支撑，制造商可能被迫削减产能以维持盈利水平。

AI（人工智能）成为市场升级的增长极

2024年12月的营收报告将AI（人工智能）定位为电子元件市场的核心增长引擎。尽管传统半导体市场复苏节奏分化，但整体趋势均指向AI（人工智能）的持续扩张与传统市场的渐进修复并行。

此外，消费电子行业的调整释放出关键信号：个人计算与移动设备板块正步入大规模升级

周期。制造商寄望于端侧AI（人工智能）驱动应用推动用户进行设备升级，[Microsoft（微软）宣布](#)将于10月14日终止对Windows 10的支持更是加剧了设备更新的紧迫性。安全更新将于10月14日后停止，迫使用户转向新设备及平台以维持系统防护与功能的完整性。



行业展望

AI（人工智能）硬件引领半导体产业革新

AI（人工智能）持续驱动多领域实现创新，[硬件](#)技术的突飞猛进正成为[半导体行业](#)增长的核心引擎。[Broadcom（博通）近期的营收报告](#)指出了AI（人工智能）芯片市场的关键趋势：XPU（极端处理单元）等定制化硅芯片需求激增。相较于Nvidia（英伟达）旗下的通用型[GPU](#)（图形处理器），XPU（异构计算处理单元）专为高算力AI（人工智能）任务设计，能在与超大规模的定制化软件层协同运行时显著提升能效。

Broadcom（博通）CEO（首席执行官）Hock Tan预测该领域将迎来爆发式增长，2027年的AI（人工智能）及AI（人工智能）网络相关营收预计将从当前的150至200亿美元跃升至[600至900亿美元](#)。亚马逊AWS、谷歌云与微软Azure等超大规模云服务商正与Broadcom（博通）联合开发AI（人工智能）加速芯片来共同引领这一浪潮。

这一趋势虽预示着专用芯片市场扩容，但业界专家普遍认为其互补性作用远大于替代性：通用型GPU（图形处理器）在基础AI（人工智能）算力中占据主导地位，定制化芯片则专注于解决超大规模场景需求。此类技术演进不仅重塑了AI（人工智能）基础设施格局，更为电子元器件产业注入了持续的增长动能。

欲了解更多关于AI（人工智能）对技术创新的影响？

点击此处阅读[State of the Industry Report 2024年第二辑：人工智能的影响](#)。

点击此处下载 

企业级AI（人工智能）算力需求推动HPC（高性能计算）与数据中心升级

HPC（高性能计算）与服务器预计将在2025年成为[企业计算](#)升级的核心驱动力。GPU（图形处理器）、[CPU](#)（中央处理器）、内存及专用存储元件的市场需求将伴随AI（人工智能）算力、云服务与数据密集型应用对大容量算力的渴求持续攀升。

“展望2025年，经过深度优化的Turin将全面覆盖从纵向扩展到横向扩展的服务器及传统CPU（中央处理器）工作负载，这具有重大战略意义。”AMD（美国超威半导体公司）董事长兼首席执行官Lisa Su博士在[2024年10月第三季度的营收报告](#)中强调，”CPU（中

央处理器）的AI（人工智能）集成加速将强化Turin在GPU（图形处理器）配置中作为头节点的重要地位，这些要素都将成为强劲动能，推动增长。”

Lisa Su博士进一步指出，AMD（美国超威半导体公司）正致力于扩展其整体工作负载，并在企业级产品上去的了重大进展。尽管企

业销售周期较长，但于AMD（美国超威半导体公司）而言，该领域对其维持并扩大市场份额，以及与AI（人工智能）市场领导者Nvidia（英伟达）的抗衡中具有关键性战略价值。

随着产业AI（人工智能）进程深化，高性能系统级元件的需求将持续升温，并驱动数据中心、AI（人工智能）创新与高速互联解决方案的协同发展。



个人计算与消费电子市场静候需求拐点

过去几年间，后疫情时代的PC（个人电脑）换机潮消退导致个人计算与消费电子市场复苏乏力。消费者对个人电子产品的升级决策逻辑已经发生转变：从原来的单纯追逐新品迭代转向了对技术突破与功能创新的实质性价值考量。

普通消费者对技术进步的反馈不如预期。早期的端侧AI（人工智能）应用——如Microsoft（微软）的Copilot与Apple（苹果）的AI（人工智能）功能——并未给消费者带来其所期待

的颠覆性体验革新。市场增长动能将取决于科技巨头能否兑现承诺，使消费者认同其本地化AI（人工智能）能力（相较云端模型而言）的投入产出价值。当AI（人工智能）模型训练成本下降至本地化方案或边缘计算方案可匹敌云端服务时，或将迎来新一轮的大规模换机周期。

值得关注的另一变量是对台式机和笔记本电脑系统尤为重要的Windows系统升级窗口：[Windows 10的服务支持将于2025年10月14日](#)

[终止](#)，未更新系统将面临显著的安全风险和病毒感染可能性，或将催生新一轮桌面设备升级潮。

Microsoft（微软）正在准备应对可能出现的需求浪潮。10月30日发布的2025财年第一季度营收报告显示，该公司在游戏、搜索与设备领域的战略聚焦已推动毛利率改善。

[Microsoft（微软）的首席财务官Amy Hood](#)表示，“Windows OEM（原始设备制造商）和设备领域收入预计将出现低至中单位数下滑。尽管Windows OEM（原始设备制造商）收入增长与PC（个人电脑）市场保持同步预期，但在第一季度颓势的延续下，设备业务的下滑将完全抵销这一正向表现。”



电动汽车市场分化加剧全球汽车产业格局

步入2025年，[汽车行业](#)呈现显著分化态势。中国EV（电动汽车）市场销售规模持续扩张，BYD（比亚迪）等制造商凭借价格优势加速全球化布局，并在新加坡等市场实现突破。

Allegro Microsystems总裁兼首席执行官Vineet Nargolwala在[10月下旬的第二季度营收报告](#)中指出：“全球汽车架构对高度差异化的磁传感与功率半导体解决方案的持续需求令人振奋，渠道库存平衡重建亦取得重

大进展。中国OEM（原始设备制造商）厂商正以超20%的新能源汽车产量增速全速推进，全价格段的新品矩阵也在加速完善。”

反观欧美市场，汽车需求持续低迷，传统燃油汽车的销量不断下滑。经济压力进一步抑制了EV（电动汽车）的区域渗透率提升，致使该区域进入低速增长周期，其所面临的来自中国制造商的竞争压力持续加大。

工业领域复苏启动

2024年，受到自动化与设备投资收缩的冲击（尤以欧洲为甚），[工业领域](#)面临重大挑战，但边缘计算与本地化AI（人工智能）应用等新兴技术的发展为2025年的渐进复苏注入了动能。

此类创新技术预计将重点驱动工厂自动化与智能制造解决方案需求增长，随着针对个体运营需求的定制化AI（人工智能）解决方案在企业中逐步渗透，Nvidia（英伟达）Jetson系列等中低端GPU（图形处理器）元件或将捕获新一波动能。

“2025年边缘计算的崛起将重构企业AI（人工智能）应用范式，通过降低延迟以及为智能本地化赋能获取全新的行业竞争优势。”

Marcus Chen

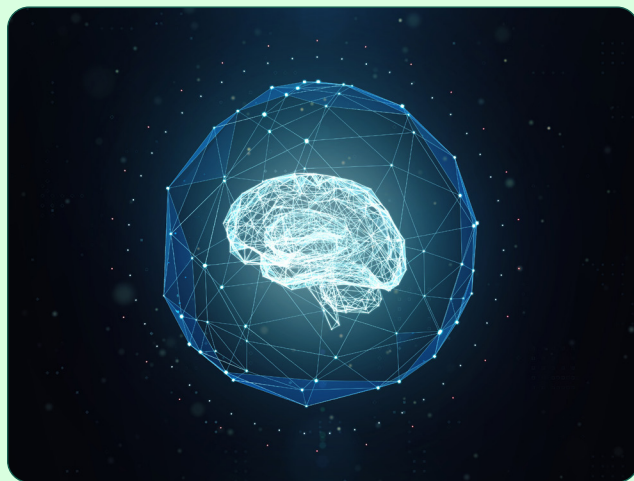
Fusion Worldwide（孚昇电子）执行副总裁

动态演进中的市场格局

简而言之，AI（人工智能）仍然是跨产业发展的核心叙事，但其成功取决于能否实现真正具有变革性的应用落地。高性能计算持续引领增长，个人计算和消费电子领域静待技术突破。

汽车与工业领域复苏有望，本地化AI（人工智能）解决方案的进展将托举其复苏进程。需注意的是，地缘政治的紧张局势、贸易政策波动与区域制造依赖仍在持续扰动全球供应链稳定性。

在2025年的市场竞争中，有效驾驭不确定性并把握新兴技术红利，将成为企业构建竞争优势的关键战略能力。



全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈

随着全球地缘政治格局进一步复杂化，电子元器件等领域的全球供应链稳定性面临着重大不确定性。美国政治格局的演变将在未来数年影响电子元器件的定价水平与供应稳定性，这一影响将在拜登政府向特朗普政府的过渡中变得尤为明显。与此同时，中国的全球影响力将因其对关键原材料的掌控能力而持续强化，为电子产业的全球供应链注入新的不确定变量。

美国强化本土制造的战略部署

拜登政府延续并升级了特朗普时期对华贸易政策框架，特别针对半导体与电动汽车核心部件实施关税壁垒，遏制中国在定价战略上的优势并巩固美国本土制造的地位。2024年5月，[拜登政府宣布](#)将于2025年把部分中国进口产品（包括半导体产品）的关税从25%阶梯式上调至50%，锂离子电池、太阳能电池

及电动汽车零部件的关税更是飙升至100%之高。

此举旨在重构竞争天平，以缓解中国低成本出口给美国制造商带来的竞争压力。

受影响的产品	原301条款关税税率	新301条款关税税率	生效时间
电池组件	7.5%	25%	2024
电动汽车	25%	100%	2024
锂离子电动汽车电池	7.5%	25%	2024
锂离子非电动汽车电池	7.5%	25%	2026
半导体	25%	50%	2025
太阳能电池	25%	50%	2024

然而，关税政策的涓滴效应已然显现：企业被迫调整布局，中国出口产品的交货周期延长与价格攀升已成定局。

拜登政府通过《芯片与科学法案》等政策工具加速推动半导体等关键技术的本土化生产，

以降低对中国出口的依赖。值得注意的是，关税的上升很可能加大采购成本压力，在那些对中国出口依赖性高的业务板块表现将尤为突出。

特朗普重返执政加剧市场不确定性

特朗普重返白宫后提出的全面关税升级计划引发了全球贸易伙伴担忧，此次关税升级主要针对来自加拿大、墨西哥和中国等主要贸易伙伴的进口商品，包括对加拿大、墨西哥进口商品加征25%基准关税，并将中国商品关税再提升10%——此举可能使半导体产品的进口关税飙升至60%。

尽管最终的关税结构特朗普就任后的政治博弈，但高额的关税压力已然为全球电子元

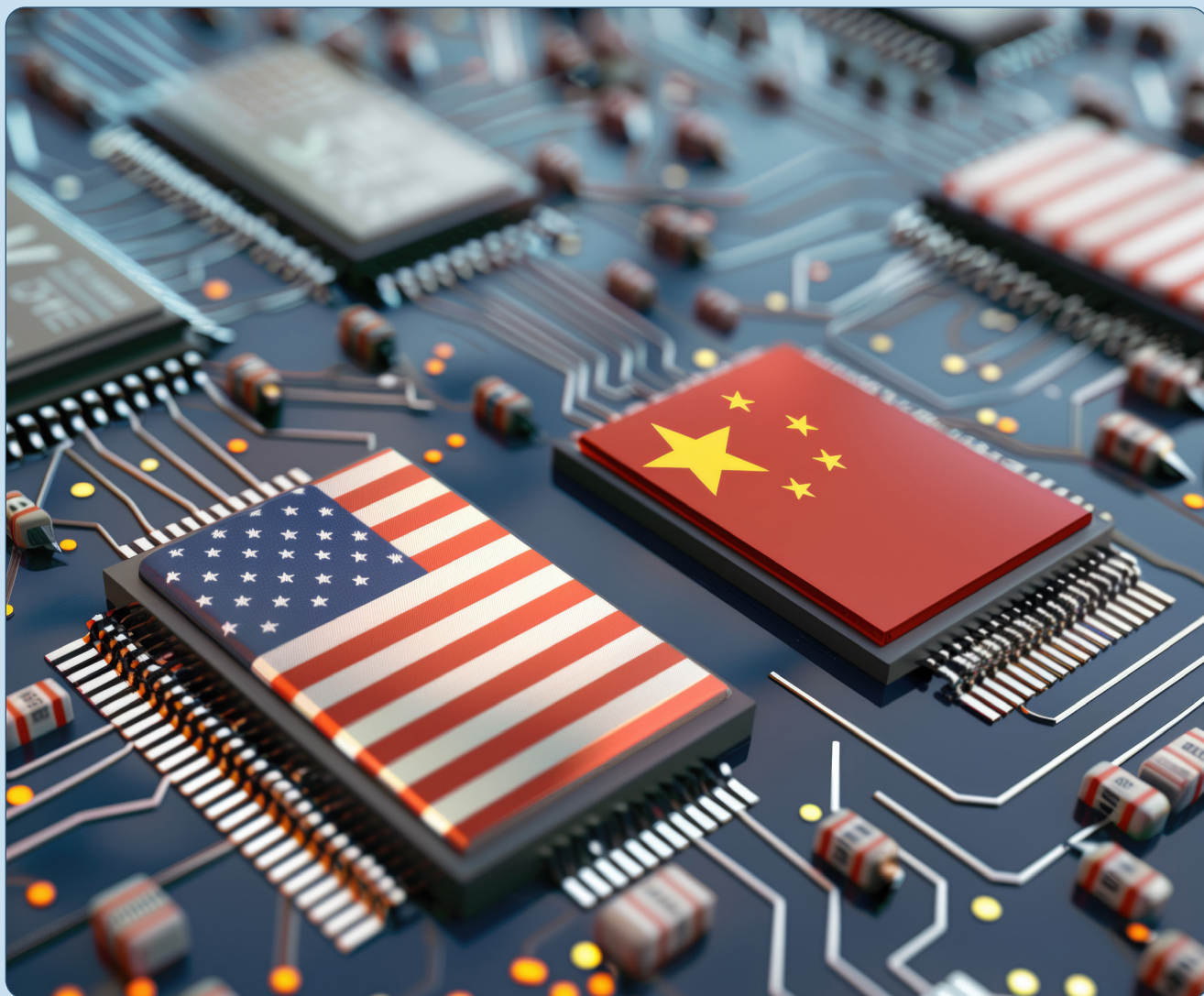
器件市场的波动埋下了伏笔。中墨两国作为美国电子元器件进口的核心供应国，占据了超过40%的美国电子元器件进口份额。此次关税政策变动将直接冲击美国本土企业的采购成本与供应链时效性，迫使企业重构采购战略。

对中国额外加征关税的行为极有可能激起中国的反制措施，贸易摩擦也会因此进一步升级。

“地缘政治摩擦与关税壁垒为本就复杂的供应链态势叠加了新的风险。即便部分企业认为自身远离中美贸易争端前线，但由此产生的成本上涨和供应受限等涓滴效应实则难以规避。”

Evan Maniquis

Fusion Worldwide（孚昇电子）销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区）



前路抉择：供应链动态博弈中的适应与发展

随着地缘政治格局持续演化，美国企业亟需适应新的贸易格局。拜登政府现行关税政策已重塑市场生态，而特朗普政府潜在的超高关税加征计划将进一步加剧电子元器件采购体系紊乱。中国反制措施风险与关键原材料主导权的强化凸显了企业在应对贸易变局时的多重挑战。

企业必须立即构建弹性供应链体系以提升战略适应性，这对探索替代性采购渠道并深度

整合市场情报网络提出了新的要求。Fusion Worldwide（孚昇电子）[12月](#)的市场情报显示，部分客户已针对HDD（机械硬盘）、SSD（固态硬盘）及存储产品启动预防性库存建设，以对冲关税升级的冲击。

2025年，企业决策层需制定关键应对方案，在保障自身经营的连续性与应对市场冲击之间寻求最优解。

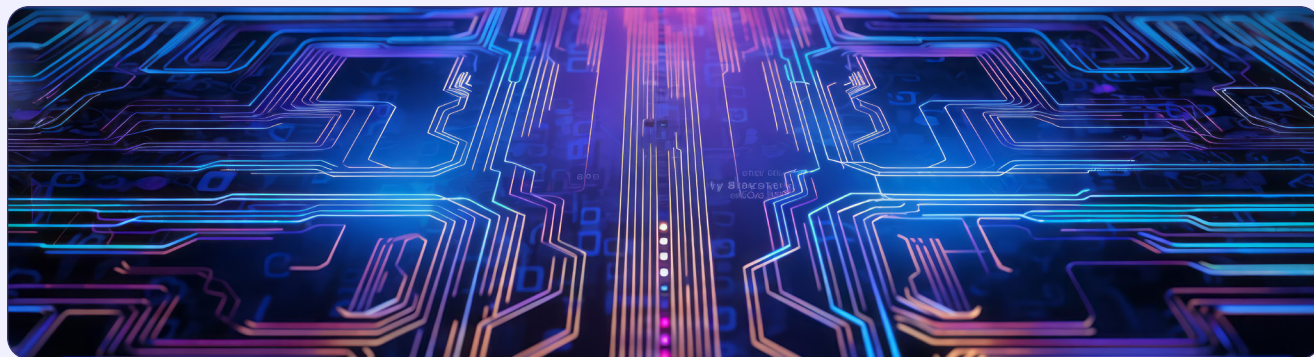
2025制胜战略框架

面对复杂的市场动态，电子行业需以韧性战略构筑竞争优势。在以下战略中，敏捷响应、协同创新与质量优先，将成为破局关键。

通过多元化布局与柔性管理化解风险

2025年，全球贸易摩擦与原材料供给受限仍是核心风险变量。供应链地理多元化战略和柔性的采购战略是企业的不二之选。

独立分销商的价值在于提供受限产能的替代方案，有效规避贸易壁垒与突发性的断供风险，并增强企业对地缘经济冲击的快速响应能力。



实时数据带动动态采购策略升级

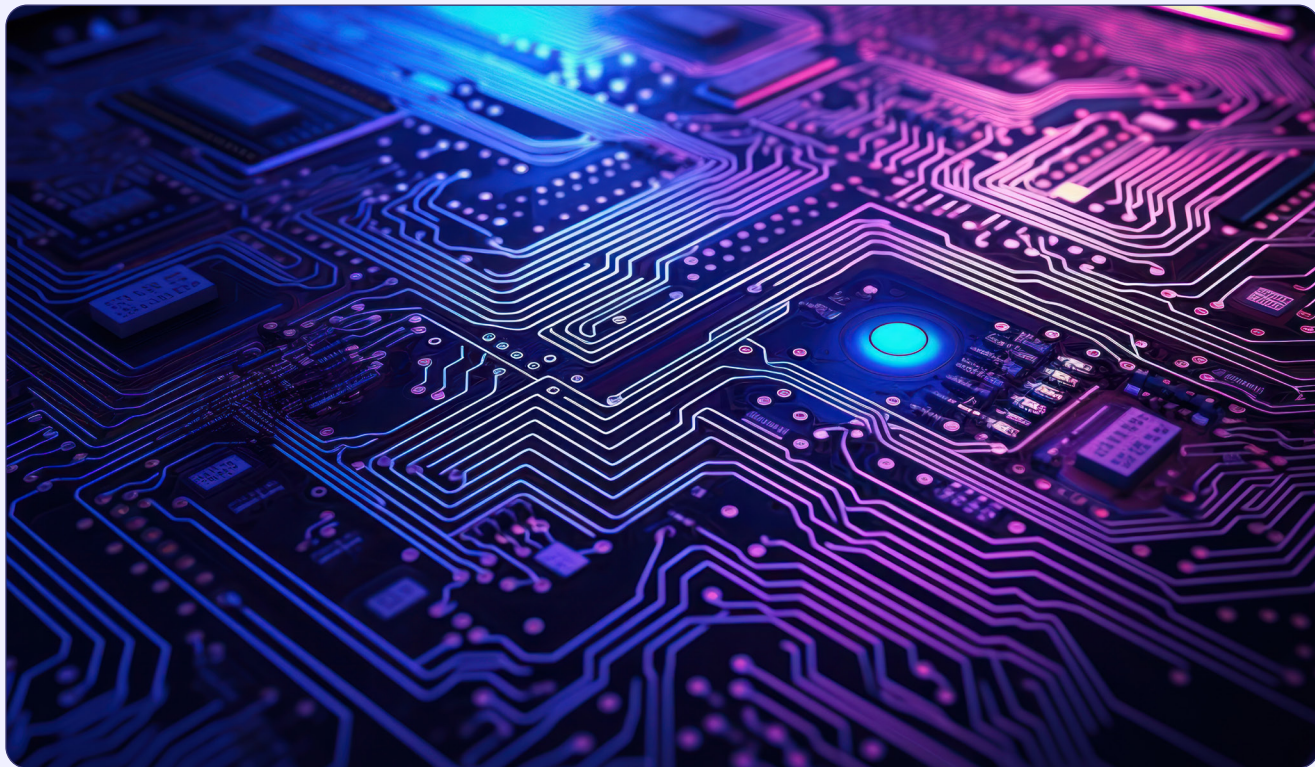
供应链的不可预测性持续走高，企业须依托实时市场情报优化采购决策模型以保持领先地位。通过动态监控库存水平、价格曲线及交付周期波动状况，规避库存冗余与短缺的风险。

通过与具备全球网络的独立分销商建立合作伙伴关系，可获取供需变化的先发性洞察，确保采购决策与市场脉动精准同步。

成本管控与质量保障的平衡

面对降本的压力，为了短期效益而牺牲质量的陷阱实在是诱惑满满。坚守质量优先原则，既是维系客户信任的基石，更是控制长期风险的关键。

降本固然重要，但在成本效益与质量有限之间实现平衡仍是制造商和供应商的同等要务。独立分销商在其中扮演着关键角色，通过严格的供应商审查与全流程质量检测体系，在保障可靠性的前提下提供成本优化方案，实现降本增效与产品性能的协同提升。



技术赋能采购体系保持竞争优势

随着技术革新持续重塑供应链形态，企业必须突破传统采购范式以构建竞争优势。在高速演进的市场环境中，制胜关键在于部署能够优化采购流程、增强供应链透明度的数字化工具。

当前，专为电子元器件设计的智能电商平台已实现库存水平与价格波动的实时追踪，赋能企业快速制定数据驱动的采购决策。此类平台不仅大幅削减了人工寻源的时间成本，更是通过关键数据的即时触达提升了运营效率。

通过系统化应用这些创新策略与工具，企业可构建前瞻性采购体系，在精准满足需求的同时规避库存过剩与交付延迟的风险。此类解决方案不仅能显著提升供应链灵活性，更将在日趋白热化的市场竞争中为企业建立差异化护城河。

携手Fusion Worldwide（孚昇电子）驭势前行

2025年，电子元器件供应链步入关键转折期，企业制胜之道在于对快速演变环境的动态适应能力。通过强化敏捷响应、协同创新与质量优先，企业可突破不确定性的迷雾，构筑可持续增长新范式。

“在当今充满变数的供应链生态中，Fusion（孚昇电子）等独立分销商正成为客户不可或缺的风险缓释方案。我们所提供的供应链柔性 with 全球资源触达能力，正是分销商难以企及的价值所在。”

Evan Maniquis

销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区）

无论是应对地缘政治风险还是供需波动管理，抑或是在授权渠道断供时补位关键元器件供应，Fusion Worldwide（孚昇电子）都能通过定制化解决方案赋能企业破局。依托全球供应网络与深度市场洞察，我们确保客户的供应链始终走在领先的前列。🔗

想要优化自身采购流程？

现在就访问Fusion Worldwide（孚昇电子）[全新的电商平台](#)，支持实时追踪全球元件库存与价格动态，并可构建智能观察清单为精准决策增速。

立即注册，获取驱动业务增长的先发性洞察。



市场情报体系

Fusion Worldwide（孚昇电子）通过深度行业洞察赋能企业前瞻性布局开放市场，结合全面的市场情报报告与实时资讯追踪系统，助您精准预判供应中断风险，构建智能决策中枢。

Fusion Worldwide（孚昇电子）市场情报产品体系



The Greensheet是Fusion Worldwide（孚昇电子）出品的有关电子元器件供应链和公开市场动态的月度洞察报告，涵盖多品类供需趋势与价格走势研判。

Rapid Response为您提供突发新闻事件的即时分析与电子元器件供应链的价值洞察，通过实时风险预警，助您建立敏捷应变机制。



点击订阅，获取市场情报邮箱推送